

东方证券股份有限公司

关于烟台德邦科技股份有限公司

2025 年度持续督导跟踪报告

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“保荐机构”）作为正在履行烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“德邦科技”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，负责德邦科技上市后的持续督导工作并出具本年度持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	实施情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与德邦科技签订《保荐协议》，已明确双方在持续督导期间的权利和义务，并已报上海证券交易所备案
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期及不定期回访等方式了解德邦科技业务经营情况，对德邦科技开展持续督导工作
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	在本持续督导期间，德邦科技未发生按相关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	在本持续督导期间，德邦科技未发生违法违规或违背承诺等事项
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	在本持续督导期间，保荐机构督导德邦科技及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构已督促德邦科技进一步完善公司的治理制度并严格执行
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部	保荐机构已督促德邦科技建立健全相关内部控制制度，且得到了有效执行，未发现德邦科

序号	工作内容	实施情况
	审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序和规则等	技内部控制制度执行存在失效的情况
9	督促上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分的理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构已督促德邦科技按照中国证监会、上海证券交易所相关规定建立健全信息披露制度，并按制度规定严格执行，并已审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	在本持续督导期间，保荐机构对德邦科技的信息披露文件进行了事前或事后的及时审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完成内部控制制度，采取措施予以纠正	在本持续督导期间，德邦科技及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在前述情况
12	持续关注上市公司及其控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	在本持续督导期间，德邦科技及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报告，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	在本持续督导期间，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	在本持续督导期间，德邦科技未发生前述情况
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量	保荐机构已制定现场检查的相关工作计划，并明确了具体的检查工作要求
16	上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）	在本持续督导期间，德邦科技不存在前述情形

序号	工作内容	实施情况
	违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形	

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

在本持续督导期间，保荐机构和保荐代表人未发现德邦科技存在需整改的事项。

三、重大风险事项

公司目前面临的风险因素主要如下：

（一）核心竞争力风险

1、产品迭代与技术开发风险

公司作为专注于高端电子封装材料研发与产业化的国家级专精特新重点“小巨人”企业，产品主要应用于集成电路封装、智能终端封装及新能源等新兴领域。行业内技术升级与产品更新换代速度较快，公司主要竞争对手为国际知名企业，需持续投入研发以推出满足客户需求的新产品，并在技术层面参与激烈竞争。这对公司研发创新能力、技术响应速度、技术储备与行业新需求的匹配度均提出较高要求。

若公司未能精准把握下游行业发展趋势，或研发能力、响应速度、现有技术储备无法满足客户对新型封装工艺及应用场景的要求，在技术竞争中处于不利地位，将导致公司产品与下游技术需求的适配性降低，进而对产品销售、市场拓展及盈利能力产生负面影响。

2、关键技术人员流失风险

高端电子封装材料行业具有显著技术密集型特征，关键技术人员是公司保持持续竞争力、实现技术创新的核心要素。未来若公司薪酬水平在行业内不具备竞争优势，或人力资源管理、内部晋升机制未能有效落地，可能导致高端技术人才引进困难，甚至出现核心技术人员流失，从而对公司生产经营及持续发展造成不利影响。

3、核心技术泄密的风险

公司拥有多项电子级粘合剂制备、功能性薄膜材料制备等相关核心技术，核心竞争力主要体现在产品配方的持续研发创新与生产工艺流程的优化。若核心配方、生产工艺等关键技术被复制或泄露，将削弱公司市场竞争力，对经营业绩产生不利影响。

(二) 经营风险

1、业务规模扩张引发的管理风险

随着公司资产、业务、机构及人员规模持续扩张，经营管理复杂度显著上升，对公司在市场开拓、产品研发、制造能力、质量管理及内部控制等方面的管理水平提出了更高要求。若公司的治理机制与运营能力未能及时匹配内外部环境的变化进行优化提升，可能导致管理效率下降，进而对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。

2、经营规模偏小、抗风险能力较弱的风险

报告期内，公司营业收入为 154,723.09 万元，虽保持稳步增长态势，但与境内外行业头部企业相比，公司整体经营规模仍相对较小，抵御市场波动及经营风险的能力较弱。受限于当前业务承载能力，公司在市场开拓、研发投入等方面仍存在一定不足，面对持续增长的客户需求，可能无法足额承接全部订单，进而错失部分市场机遇，导致营业收入增长放缓。

(三) 财务风险

1、毛利率波动风险

根据应用领域与场景的差异，公司产品包括集成电路封装材料、智能终端封装材料、新能源应用材料以及高端装备应用材料这四大类别。报告期内，公司业务整体呈现强劲发展态势。然而，受行业现状、市场供求、产品技术特性、更新换代节奏及销售策略等多重因素综合影响，不同类别产品的毛利率存在一定差异。

由于各类产品面临的市场竞争环境、生命周期阶段、更新迭代进度、销售结构及原材料价格波动影响，公司面临毛利率下降的风险。若公司未能及时根据市场变化推进技术升级，导致产品技术先进性不足；或市场推广效果未达预期，造

成高毛利产品销售增速放缓、收入占比降低；又或原材料价格大幅上涨，均可能使毛利率进一步下滑，进而对公司的经营业绩和盈利能力产生负面影响。

2、汇率波动的风险

汇率随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有一定的不确定性，同时随着公司全球化布局的深入，公司产品进出口涉及美元及其他外币的汇兑，如果相关币种汇率波动，不能采取有效措施规避人民币升值风险，则公司将面临盈利能力受汇率波动影响的风险。随着公司境外相关业务规模的持续扩大，如果未来汇率出现大幅波动，公司将面临着一定的汇率风险导致汇兑损失的产生，从而对公司的经营成果和财务状况造成不利影响。

公司将加强资金筹划与管理，以防止汇率波动所带来的风险，同时也会密切关注汇率的波动和走势。及时掌握货币结算的政策和趋势，适时采取必要的措施，弱化汇率波动的风险，尽可能的降低汇率波动的不利影响。

3、应收账款无法按期收回的风险

随着公司经营规模的持续扩大、或者受市场环境、客户经营情况、信用政策变动等因素影响，公司应收账款余额可能保持较大规模。如果公司主要客户的财务状况出现恶化，可能出现较大应收账款不能收回或延期收回的情况，进而对公司资金周转和生产经营产生不利影响。

公司高度重视应收账款管理工作，建立了全流程、闭环式的应收账款风险管控机制：1）搭建严格的客户授信评估体系，依据客户类型、合作历史及信用状况等因素，合理审定信用额度与账期。2）执行标准化逾期账款催收程序，通过销售跟进及正式催收函等措施及时回收货款，并将客户逾期纳入销售绩效体系，确保整体逾期风险可控。3）持续定期评估信用政策，动态管控应收账款风险，进一步筑牢应收账款风险防线。

4、税收优惠变化的风险

公司在 2023 年度、2024 年度和 2025 年度，税收优惠金额分别为 1,618.60 万元、1,701.37 万元和 2,064.95 万元，占利润总额的比例分别为 13.81%、15.37% 和 17.71%。如果国家有关高新技术企业等税收优惠的法律、法规、政策发生重大调整，或者由于公司未来不能持续取得国家高新技术企业资格等原因而无法获

得税收优惠，将对公司经营业绩造成不利影响。

5、政府补助降低的风险

公司在 2023 年度、2024 年度和 2025 年度，公司计入当期损益的政府补助（包括增值税加计扣除）分别为 1,960.12 万元、1,665.54 万元和 1,967.11 万元，占利润总额的比例分别为 16.72%、15.04%和 16.91%。如果未来政府部门对相关产业的政策支持力度减弱，或者其他补助政策发生不利变化，公司取得的政府补助将会减少，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

6、商誉减值风险

本报告期初商誉账面原值为 7,099,450.64 元，该商誉为本公司收购东莞德邦公司时形成。东莞德邦公司经营状况良好，目前不存在需要计提商誉减值准备的情况，如果未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险。本报告期内公司完成了对泰吉诺公司股权收购的交割及并表，支付金额超过购买日公司享有的可辨认净资产公允价值份额，形成商誉 195,651,828.61 元。泰吉诺主要从事高端导热界面材料的研发、生产及销售，并主要应用于半导体集成电路封装领域，所处行业具有研发投入高、技术迭代快、研发周期长等特点，泰吉诺的经营效益受宏观政策、经济周期、市场竞争、经营管理等多种因素的影响，可能存在业绩不达预期的风险。如果未来由于行业不景气或泰吉诺自身因素导致其未来经营状况未达预期，则公司存在商誉减值风险，从而影响公司当期损益。

（三）行业风险

1、集成电路结构性风险

集成电路国产化进程虽持续推进，但结构性风险依然严峻。当前，行业面临的首要挑战在于地缘政治博弈加剧，以美国为首的“芯片法案”及技术出口管制措施，正对包括高端光刻机、特定 EDA 工具与先进制程设备在内的关键环节形成封锁，导致国内产业链在获取先进技术、设备与 IP 上面临持续压力。其次是核心技术突破瓶颈，尽管 7 纳米等成熟工艺稳步推进，但在 3 纳米及以下制程、计算光刻软件、EUV 光刻工艺与 Chiplet 架构的核心标准、先进封装工艺（如 3D 集成所需高深宽比 TSV、混合键合等）方面，仍与国际顶尖水平存在差距，存在被“卡脖子”的风险。行业竞争也呈现白热化，国际巨头凭借其技术生态优势

与庞大的资本开支，不断强化先进工艺与产能壁垒，加剧了对高端市场的争夺。此外，半导体是典型的技术与资本密集型产业，持续高强度的研发投入与高端复合型人才短缺，共同构成了制约国产化进程的长期挑战。

2、智能终端行业风险

智能终端行业当前面临市场需求、供应链安全及技术迭代的多重风险交织。供应链层面，地缘政治冲突加剧贸易政策不确定性，关税壁垒与出口管制扰乱全球产能布局；同时，AI算力需求爆发挤占高端存储芯片产能，传统消费电子面临关键元器件供应短缺与成本飙升的双重挤压。技术领域，端侧AI商业化落地仍存瓶颈，算力提升与能效平衡、模型安全与隐私保护等技术难题待解，创新投入与商业回报的不确定性凸显。此外，数据安全法规趋严，智能终端涉及的用户隐私泄露风险及合规成本持续上升。整体而言，行业正经历从规模扩张向质量竞争的转型阵痛，周期波动与结构性调整风险并存。

3、新能源行业风险

新能源行业面临政策合规趋严、产能过剩竞争加剧及技术迭代与供应链波动等多重宏观风险。动力电池与储能电池封装材料行业虽保持增长，但仍面临多重宏观风险：环保法规持续趋严推动企业加大环保投入，欧盟《新电池法》等国际规则对碳足迹、再生材料比例提出更高要求，叠加国际贸易摩擦，可能增加公司海外业务成本与合规压力；国内同行扩产节奏较快，若下游需求不及预期，行业可能出现阶段性产能冗余，加剧中低端产品价格竞争，挤压盈利空间；固态/半固态电池等新技术路线演进可能对现有封装材料体系提出新的性能要求，若公司研发进度滞后将面临产品迭代与替代风险，同时核心原材料价格受大宗商品波动影响较大，部分高端设备仍依赖进口，供应链稳定性与成本控制能力也面临一定挑战。

4、高端装备制造技术创新风险

公司所处的高端装备封装材料行业应用广泛，覆盖工业装备制造、轨道交通、汽车制造等核心领域，行业发展过程中需应对多重挑战：一是核心原材料价格影响，有机硅、环氧树脂等关键原材料受国际供应链、地缘政治及大宗商品价格周期等因素影响，2025年呈现阶段性价格波动，可能给公司成本控制带来一定压

力，需通过产品优化、技术降本等方式积极应对；二是技术与需求适配要求提升，下游行业技术迭代加快，新能源汽车电机高效化、轨道交通装备轻量化等趋势对封装材料的性能指标提出更高要求，公司需持续加大研发投入，确保技术创新与客户需求保持同步，以维持产品竞争力；三是市场竞争与客户合作适配挑战，行业竞争呈现分层格局，国际品牌在高端市场具有先发优势，国内市场存在价格竞争态势，同时下游高端客户对供应商资质认证标准较高、周期较长，公司需不断优化竞争策略、稳步推进市场拓展，保障业务持续发展。

（五）宏观环境风险

行业面临地缘政治与经贸政策交织的复杂宏观环境。全球地缘政治紧张局势持续升级，中美贸易摩擦及区域冲突导致供应链加速重构，“中国+1”战略推动产业链区域化布局，关税壁垒与出口管制措施推高原材料进口成本，国际化工巨头已明确将“地缘政治成本”纳入定价机制并启动多轮提价。原材料市场呈现高度波动性，MMA、环氧树脂、MDI/TDI等基础化工原料受大宗商品周期及产能分布影响价格剧烈震荡，2025年一季度环氧树脂进口成本已同比上涨18%，叠加能源价格高位运行，行业面临持续的成本传导压力。环保监管趋严构成政策高压线，中国《电子胶粘剂有害物质限量》等强制性国家标准于2025年实施，预计淘汰15%以上低端产能，欧盟REACH法规同步新增全氟化合物限制并强化供应链溯源要求，企业合规成本与环保治理投入显著攀升。宏观经济层面，全球经济复苏乏力导致下游建筑、房地产、汽车等领域需求疲软，行业正经历成本上行与需求收缩的双重挤压，同时汇率波动加剧出口型企业经营不确定性。

四、重大违规事项

在本持续督导期间，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2025年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

主要财务数据	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	1,547,230,856.71	1,166,752,095.17	32.61
利润总额（元）	116,590,253.08	110,729,073.28	5.29

归属于上市公司股东的净利润（元）	107,607,668.95	97,429,117.04	10.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	99,668,995.12	83,657,037.64	19.14
经营活动产生的现金流量净额（元）	-100,634,402.08	378,978,438.28	-126.55
主要财务数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,324,198,965.34	2,294,036,142.65	1.31
总资产（元）	3,445,636,541.72	2,969,733,400.69	16.03
主要财务指标	本报告期	上年同期	本报告期比上年同 期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.76	0.69	10.14
稀释每股收益（元/股）	0.76	0.69	10.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股）	0.71	0.59	20.34
加权平均净资产收益率（%）	4.66	4.30	增加0.36个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%）	4.31	3.69	增加0.62个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	4.70	5.73	减少1.03个百分点

上述主要财务数据及指标的变动原因如下：

报告期内，公司实现营业收入 154,723.09 万元，同比增长 32.61%。主要系公司深耕主业，依托头部客户群优势和系统化的产品布局，通过技术研发创新、产品迭代、产能建设、投资并购等举措，持续增强市场竞争力，从而实现了营业收入的稳定增长。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少 126.55%，主要系报告期内，公司票据托收及贴现减少，以及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

综上，公司 2025 年度主要财务数据及财务指标变动具备合理性。

六、核心竞争力的变化情况

（一）研发优势

公司专注于高端电子封装材料的研发和产业化，深知高端电子封装材料的技术研发和新产品开发能力对企业持续经营的重要性，因此积极布局集成电路、智能终端、新能源等前沿领域。在国家高层次海外引进人才领衔的核心科研团队长期钻研下，公司在集成电路封装、智能终端封装、新能源应用等领域实现技术突

破，在高端电子封装材料领域构建起了完整的研发体系，掌握核心技术并拥有完全自主知识产权。公司先后承担了“02 专项”“国家重点研发计划”“A 工程”和“高质量发展专项”等多个国家级重大科研项目。

公司始终坚持以自有技术建立自有品牌为目标，通过自主开发掌握了行业内领先的配方技术和工艺技术，并通过持续不断的改进，确保工艺的成熟稳定、产品性能的持续提升；通过持续的应用测试平台能力建设，不断提升客户对标以及新产品验证能力；通过关键材料的结构设计与自主合成，在确保成本优势的基础上提升公司核心竞争力；通过联合实验室共建、人才双向流动、标准共建等产学研活动的开展，实现企业与高校的优势互补与协同创新。经过多年的技术积累，公司已建立起较为完备的高端电子封装材料产品体系，并与行业领先客户建立长期合作关系，凭借强大的研发实力、可靠的产品质量和优质的客户服务，进入到知名品牌客户的供货体系，并成为客户信赖的合作伙伴；公司紧跟行业趋势，通过持续的研发投入、人才的持续引入和创新，不断提升研发能力，巩固核心竞争力，保持了技术领先和产品迭代的优势，以应对日益激烈的市场竞争，实现可持续发展。

报告期内，公司在标准制定、技术创新与数智化研发建设方面取得重要突破。由公司主导制定的 1 项行业标准获工信部正式立项，牵头参与的 2 项国家标准已进入批准发布阶段，行业影响力与话语权持续提升。1 项重大科技成果经院士专家组鉴定，整体技术达到国际领先水平，彰显公司核心技术竞争力。同时，公司积极推进 AI 技术在新材料研发领域的创新应用与赋能落地。ELN 电子实验记录本已成功上线运行，以研发数据结构化管理与核心数据库建设为抓手，规范实验过程、沉淀知识资产，为后续 AI 数据分析、模型构建与智能研发奠定坚实基础，有效提升研发效率与创新质量，驱动技术研发向数智化、高效化、精准化转型。

（二）人才优势

报告期内，公司坚持人才驱动发展，持续优化结构，构建核心竞争优势。核心管理与技术团队以国家高层次人才为引领，汇聚行业深度与国际视野兼具的专业人才。团队在集成电路封装、新能源等关键领域不断突破，完善研发至量产全链条，掌握核心工艺。核心管理层凭借战略规划与市场拓展积淀，精准把握趋势，推动技术与市场融合。目前公司硕士及以上 115 人，占比 11.73%；研发技术团

队高级职称 19 人，含多名省级以上领军人才，形成高层次人才引领、中青年骨干支撑的专业队伍。

人才梯队建设坚持“引育并举”。“雏鹰计划”通过 6 个月系统培训与导师带教加速青年成长。至年末研发人员 184 人，同比增 18.71%，人才结构持续优化。公司升级多元化培养机制，覆盖多岗位序列，形成“引进—培养—成长—留存”良性循环。

此外，公司通过完善激励、搭建平台、人文关怀营造良好生态，提升人才归属感，推动人才价值与公司发展深度绑定，为高端电子封装材料领域持续领跑筑牢根基。

（三）生产优势

公司具备快速高效的市场响应能力。下游应用领域呈现产品迭代周期短、技术更新快、消费热点切换迅速的行业特征，对上游材料供应商提出快速研发、快速适配的核心要求。公司依托高效研发体系，可快速响应并匹配客户工艺需求，持续支撑下游产品迭代升级。

同时，公司主要服务于行业内知名品牌客户，下游客户对供应链管理要求严苛，普遍需要即时响应、快速交付、短采购周期的保障能力。为此，公司建成行业领先的高端电子封装材料智能制造工厂，拥有一支对行业趋势与产品特性理解深刻的专业化生产团队，生产管理规范、运营效率突出，可快速响应客户实时订单需求，高效组织生产并稳定供货。

公司始终秉承“以质立命，以精立业，持续满足客户需求”的质量方针，以致力于成为全球高端封装材料引领者为愿景，围绕产品导入全流程构建成熟完善的全链条质量保证体系，实现从产品研发、供应商管理、进料检验、过程控制、出货管控、客户服务到产品持续优化迭代的全过程质量管控。公司已通过 ISO9001:2015 质量管理体系、IATF16949 汽车质量管理体系、ISO14001:2015 环境管理体系、ISO45001:2018 职业健康安全管理体系及 QC080000 有害物质过程管理体系等多项权威第三方认证，为产品品质与交付稳定性提供坚实保障。

（四）客户资源优势

高端电子封装材料是决定终端产品性能、稳定性及结构密封防护水平的核心

关键材料，对终端产品品质具有决定性影响。因此，原材料品质成为品牌厂商遴选供应商的核心指标，进入其合格供应链的门槛极高，客户壁垒显著。

依托下游高端应用领域的快速发展，公司始终以客户需求为中心，深耕细分赛道、持续迭代产品，不断夯实核心供应商地位，构筑起难以复制的市场壁垒。

经过多年深耕，公司已积累行业顶级、结构多元、覆盖高端赛道的优质客户资源：在集成电路封装领域，公司芯片固晶材料、晶圆 UV 膜等关键材料已实现规模化供货，服务华天科技、通富微电、长电科技、日月新等全球头部封测企业；在智能终端领域，高端封装材料批量应用于苹果、华为、小米等全球一线品牌；在新能源领域，成功切入宁德时代、中创新航、比亚迪、通威股份、阿特斯等行业龙头供应链。

上述优质客户资源，既是公司技术实力与产品品质的权威认可，也为公司持续稳健发展提供了强有力支撑与长期增长保障。

为进一步深化战略合作，公司持续加强与终端品牌的联合技术开发与前瞻需求对接，精准把握行业技术演进与产品迭代方向，确保研发与市场同频同步。公司以核心技术为底座，为客户提供高端电子封装材料及一体化解决方案，实现技术优势与客户资源优势深度融合，持续巩固行业领先地位，全面提升核心竞争力，引领高端电子封装材料行业高质量发展。

（五）丰富的系统解决方案优势

公司在打造高性能产品的基础上，依托扎实的技术研发能力与深厚的专有技术积淀，为客户提供全方位系统化解决方案。凭借多年积累的研发与应用数据库，公司可实现更精准、更高效的研发迭代。

从产品设计、生产应用与技术培训，到持续的售后服务及产品技术升级，公司始终以客户需求为核心，致力于提供一站式高端电子封装材料解决方案。公司深度参与客户新产品开发全流程，提供性能提升方案、材料配方设计、样品测试验证等一体化服务，通过定制化服务精准响应客户个性化需求，实现与客户的协同研发与高效联动，有效提升客户满意度，持续深化与下游客户的战略合作关系。

高端电子封装材料的性能受工艺条件、胶体特性、使用环境、老化性能及可靠性要求等多重因素影响。为此，公司与客户紧密协作，共同开发适配特定工艺

参数与应用场景的产品方案。这种以客户需求为导向的服务模式，推动公司持续优化产品性能，精准满足市场对高端封装材料的严苛要求。

公司系统化解方案的核心优势，既体现在过硬的技术实力，更体现在对客户需求的深度理解与高效落地。这一优势不仅显著提升了客户满意度与合作黏性，也进一步巩固了公司在高端电子封装材料领域的市场领先地位。

七、研发支出变化及研发进展

报告期内，公司始终坚持人才强企、创新驱动战略，高度重视科研人才队伍建设，持续加大引才力度、完善培养体系，聚力打造高水平科研团队。截至报告期末，公司拥有国家级海外高层次专家 2 人，研发团队规模扩充至 184 人，较去年增长 18.71%，为技术突破与项目攻坚提供坚实人才支撑。

公司研发投入稳步增长，总额达 7,267.37 万元，较上年同期增长 8.71%，研发费用占营业收入比例为 4.70%。持续加码的研发投入，为技术创新与产品升级提供充足资金保障，以创新产品赋能业务发展，有效提升公司市场竞争力与品牌影响力。

（一）核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

高端电子封装材料已超越传统粘接、密封与防护功能，逐步具备导电、导热、电磁屏蔽、绝缘、防水及耐汗液等多重特殊性能，成为电子器件稳定运行的关键支撑。针对集成电路封装、智能终端封装、新能源动力电池封装、光伏电池封装等不同应用场景，材料性能与技术要求差异显著，其核心技术集中体现在配方设计与体系复配，主要包括基体树脂的选型与改性、功能填料的筛选与复配、界面处理技术以及各类助剂的优化搭配等。各组分之间的精准协同与精细化混合工艺，更是构成高端电子封装材料的核心竞争力。

功能性封装材料行业对企业创新能力要求极高，需要在高分子合成技术、实验室配方开发、材料性能测试及数据积累与应用等方面具备深厚功底，企业必须拥有自主研发能力，才能根据客户定制化需求，开发出满足严苛工况的专用材料。该行业具有应用领域广、细分品类多、技术迭代快的特点，材料研发与性能优化依赖长期持续的技术积累。随着人工智能与自动化装备的快速发展，封装材料生产将向智能化、自动化方向升级，进一步提升生产效率、稳定产品品质、降低制

造成本。在“双碳”战略背景下，绿色环保已成为行业发展的重要方向，高污染、高能耗的传统产品与产能将逐步被替代，水基型、热熔型、无溶剂型、紫外光固化型、高固含量型及生物降解型等环境友好型封装材料将迎来更广阔的应用空间。

历经二十余年的技术深耕与积累，公司已搭建起覆盖环氧、有机硅、丙烯酸、聚氨酯等电子级树脂，以及填料、助剂等关键组分的复配改性技术平台，可根据应用需求定制开发不同理化特性与功能材料，并快速实现产品迭代升级。公司同时实现了特种单体、核心树脂等关键原材料的自主合成与改性，有力推动了关键材料国产化，进一步提升了产品核心竞争力。在国家高层次海外引进人才的引领下，公司核心技术团队在集成电路封装、智能终端封装、新能源应用等领域实现多项技术突破，构建了完善的研发与生产体系，掌握了低致敏高分子合成、树脂及特种粘接剂自主制备、专用增韧剂合成、高分子材料接枝改性、防静电晶圆切割易拾取、高导热界面材料润湿分散等一系列核心技术。。

（二）报告期内获得的研发成果

1、知识产权项目情况

2025 年度，公司及其子公司获得的知识产权如下表所示：

项目	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	110	20	898	356
实用新型专利	37	39	81	81
外观设计专利	0	0	1	1
软件著作权	0	0	6	6
其他	0	0	0	0
合计	147	59	986	444

2、在研项目情况

公司及子公司的在研项目具体明细如下：

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	摄像模组用封装材料技术研发	400.00	252.90	252.90	研究开发阶段	研发具有低收缩率、高粘接强度、耐高温与高可靠性的摄像模组用封装材料	国内领先	广泛应用于车载摄像头模组、手机摄像头模组、安防摄像头模组等领域，在摄像模组封装过程中，可以提高包含图像传感器、镜座、马达、镜头等零配件的组装准确性，确保摄像模组的使用稳定性。
2	先进封装用关键材料 IHSSealant 技术研发及产业化	700.00	588.00	588.00	产品验证阶段	按客户要求进行产品的开发以及优化提升，解决客户进口产品的完全替代以及 BLT 控制的工艺痛点。	国内领先	芯片 IHSSealant 在芯片封装中起到连接散热盖板与芯片基板、保护硅晶片、控制芯片模块的厚度、控制芯片加工使用过程中的翘曲开裂的作用以及抑制底部填充材料以及热界面材料的缓冲震动，是芯片封装过程的三大封测材料之一。
3	电芯粘接耐电解液材料研发	2,200.00	344.34	1910.56	应用拓展阶段	研发耐电解液腐蚀，高粘接力，不与电解液反应，不影响锂电池电性能，提高锂电池性能材料	国际先进	电芯粘接耐电解液材料主要用于电芯内部和外部的粘接、密封和固定，起到保护电芯和提高电芯性能的作用，应用于智能手机、笔记本电脑等电子产品、新能源动力电池、储能电池等领域。
4	电子环氧及聚酰胺材料研发	1,500.00	538.23	1381.92	应用拓展阶段	在国内规模组装厂商推广，通过客户验证，形成稳定订单。	国内领先	广泛应用于温度敏感元器件的结构粘接，可以提高封装组件的耐湿热和抗跌落效果，保证封装组件的稳定性。

5	电子丙烯酸材料研发	2,400.00	490.76	2118.13	应用拓展阶段	研发不含致敏单体，具有高粘接力、高可靠性及较好的耐化性材料	国际先进	该技术产品具有低致敏性，在智能终端可穿戴电子产品制造领域中应用广泛，适用于制造各种穿戴电子产品，如 TWS 耳机、智能手表等。
6	光伏叠晶材料研发	2,200.00	542.69	1965.22	应用拓展阶段	研发粘接强度高，模量低，体积电阻率低，210 电池不碎片的材料	国内领先	光伏叠晶材料是太阳能电池制造的关键材料之一，主要应用于太阳能电池、环保节能、新能源、科技创新等领域。
7	新能源动力电池用粘接材料研发	2,700.00	829.56	2483.79	应用拓展阶段	研发具有超高性价比、高粘度、高强度、适宜模量、优异的耐老化性能以及系列化的导热性材料	国际先进	广泛应用于新能源动力电池以及储能电池的粘接，可以提高电池组件的连接和固定效果，保证电池组件的安全和稳定性。
8	反应型聚氨酯热熔胶材料研发	1,600.00	741.72	1326.54	应用拓展阶段	研发适用于电子消费品类组装与结构粘接的材料；在主流智能手机及耳机领域，车载电子类占据较大市场份额	国内领先	适用于消费电子类的结构粘接，减少螺丝等应用，增加结构的密封性，减轻器件的重量，提高使用体验。
9	电子组装防护特种有机硅材料研发	1,400.00	305.36	1314.90	应用拓展阶段	研发施胶可满足点胶、喷胶等多种不同条件需求，施胶后 15min 可通过气密性测试验证，粘接强度 $\geq 4\text{MPa}$ 材料	国际先进	电子组装防护特种有机硅材料，具有优异的耐高温、耐化学性、抗 UV 等特性，能够有效保护电子元器件，提高电子产品的稳定性和可靠性，延长其使用寿命。广泛应用于手机、平板电脑、LED 灯具、汽车电子、医疗电子等领域。
10	半导体用精密涂布膜材料	2,400.00	400.51	2137.27	应用拓展阶段	研发适用于包括 CIS 传感器、OLED 面板、MEMS 传感器、LED 框架、IRCF 等各领域用 UV 减粘胶带	国际先进	UV 减粘膜主要应用于 CIS 传感器、OLED 面板、MEMS 传感器、LED 框架、IRCF 等半导体封装领域。

11	摄像头模组用AA制程材料研究开发项目	500.00	127.20	338.52	应用拓展阶段	研发适用于摄像模组封装过程中的具有高粘接强度，高可靠性的一系列AA制程胶黏剂	国内领先	广泛应用于摄像模组封装过程中，提高包含图像传感器、镜座、马达、镜头等零配件的组装准确性，保证摄像模组的使用稳定性。
12	有机硅/MS粘接材料研发	300.00	148.08	148.08	应用拓展阶段	研发施胶可满足手动打胶，机械点胶、喷胶等多种不同条件需求，适用于传统及新能源汽车行业的高可靠性的密封粘接材料	国内领先	有机硅/MS产品凭借其卓越的综合性能（特别是耐候性、粘结性、弹性、环保性）被广泛应用于汽车制造与维修领域，如车身密封、车窗玻璃粘接、内饰件粘接与密封、车灯密封、新能源车电池包电池箱体接缝密封以及轨道交通、船舶密封等领域
13	高导热聚合物热界面材料开发及产业化和原材料国产化	4,000.00	1036.86	3812.82	应用拓展阶段	原材料国产化，研发可自动化点胶，具有高可靠性和高覆盖率的导热界面材料	国内领先	高导热聚合物热界面材料是一种高性能的散热材料，可以有效地提高电子元器件的散热能力，保障电子产品的稳定性和可靠性。在电子、通信、汽车、工业控制等领域得到广泛应用。
14	高导热导电胶关键技术研究及产品开发	500.00	23.48	133.03	应用拓展阶段	导热>40w/m.K，应用国内高阶IC封装产品	国际先进	随着薄型化、微型化、高密度等封装需求，封装材料导热性相对提高，现行材料难以满足，故需要开发更高导热封装材料。
15	高算力芯片用导热界面材料开发及产业化	1,000.00	709.21	709.21	产品验证阶段	研发适用于高算力芯片用的高性能、高可靠性导热界面材料	国际领先	项目所研发材料具有高导热、低热阻、高可靠性等性能，可广泛应用于数据中心、服务器、交换机、智能汽车等领域。

16	半导体芯片和高功率器件用高性能热界面材料研发及产业化项目	500.00	125.73	125.73	研究开发阶段	研发适用于半导体芯片及高功率器件散热使用的高性能导热界面材料	国际领先	该项目所研发的热界面材料具有优异的导热性能、稳定性及严酷条件下的长期可靠性，尤其适用于高功率密度的半导体芯片和电子发热器件的应用场景及领域。
合计	/	24,300.00	7,204.62	20746.61	/	/	/	/

八、 新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、 募集资金的使用情况及是否合规

（一）首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可〔2022〕1527号文《关于同意烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，烟台德邦科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,556.00万股，每股发行价格46.12元，募集资金总额为164,002.72万元，扣除不含税发行费用152,543,951.12元后，本公司本次募集资金净额为1,487,483,248.88元。

截至2025年12月31日，首次公开发行股票募集资金存储账户余额为人民币43,745,081.69元，募集资金使用情况具体如下：

发行名称	2022年首次公开发行
募集资金到账时间	2022年9月14日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	164,002.72
其中：超募资金金额	84,369.13
减：直接支付发行费用	15,254.4
二、募集资金净额	148,748.32
减：	
以前年度已使用金额	95,277.54
本年度使用金额	32,055.51
现金管理金额	22,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.73
加：	
募集资金利息收入	4,959.96
三、报告期期末募集资金余额	4,374.50

综上，公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管

规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和核心技术人员持股、质押、冻结及减持情况

截至2025年12月31日，公司控股股东为解海华、陈田安、王建斌、林国成及陈昕。公司实际控制人、现任董事、高级管理人员和核心技术人员直接及间接持有公司股份的情况如下：

单位：股

姓名	职务	直接持股数	间接持股数	合计持股数	持股比例
解海华	董事长	1,509.03	498.94	2,007.97	14.12%
陈田安	董事、总经理、核心技术人员	311.94	-	311.94	2.19%
王建斌	董事、副总经理、核心技术人员	868.21	-	868.21	6.10%
林国成	实际控制人之一	1,320.82	-	1,320.82	9.29%
王艺涵	董事	-	-	-	-
张丹	董事	-	-	-	-
李明	独立董事	-	-	-	-
唐云	独立董事	-	-	-	-
宋红松	独立董事	-	-	-	-
陈昕	副总经理	175.32	-	175.32	1.23%
于杰	副总经理、董事会秘书、财务总监	2.10	389.75	391.85	2.75%
徐友志	副总经理、核心技术人员	1.70	-	1.70	0.01%
姜贵琳	核心技术人员	-	7.42	7.42	0.05%
潘光君	核心技术人员	-	3.71	3.71	0.03%
姜云	核心技术人员	-	0.74	0.74	0.01%
合计		4,189.12	900.56	5,089.68	35.78%

截至 2025 年 12 月 31 日，董事长解海华所持公司 75.00 万股股份存在被司法冻结的情形，公司已于 2023 年 6 月 2 日发布《烟台德邦科技股份有限公司关于股东所持公司部分股份被司法冻结的公告》（公告编号：2023-024）对相关信息进行披露。

2025 年度，因股权激励归属获得股份，核心技术人员姜贵琳、潘光君和姜云分别获得 17,040 股、12,390 股和 12,390 股，三人在当期将激励归属所得股份全部减持。

除此之外，上述其他人员持有的德邦科技股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、本所或者保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）

(本页无正文,为《东方证券股份有限公司关于烟台德邦科技股份有限公司
2025年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人: 王国胜
王国胜

李天雄
李天雄



2026 年 4 月 10 日